

高密度封装基板



[高密度封装基板_下载链接1](#)

著者:田民波 编

出版者:清华大学出版社

出版时间:2003-9

装帧:简装本

isbn:9787302063865

本书从印制线路板和微电子封装的基本概念入手，针对高密度多层基板，详细讨论了制造工艺、相关材料及应用等各个方面的内容。主要包括印制线路板概述、高密度电子封装、无机封闭基板、高密度封装基板及其新课题、封装用一般有机基板材料、带载型封装用挠性基板材料、封装用积层板基材、高密度互连多层板芯制造技术、高密度互连积层板制造技术、特性阻抗和集成元件板等。

本书适合于微电子、化工、材料、电子元件器件、信息、通信、计算机、机械、塑料加工等各个领域的学生、教师和工程技术人员参考使用。

作者介绍:

目录:

[高密度封装基板_下载链接1](#)

标签

评论

[高密度封装基板_下载链接1_](#)

书评

[高密度封装基板_下载链接1_](#)